Date/Month/Year

送付先：Fax: 03-5733-4973

Email: 3dic\_2019@semiconportal.com

**IEEE International 3D Systems Integration Conference(3DIC) 2019**

**Exhibit Application Form**

|  |  |
| --- | --- |
| お申込み社（機関）名Affiliation Name |  |
| 社名板（日本語）Name for affiliation board　(Japanese) |  |
| 社名板（英語）Name for affiliation board　(English) |  |
| 担当者名Contact person’s name |  |
| 部署名Department |  |
| 役職名Job title |  |
| 住所Post mail address | 〒 |
| Tel |  |
| Email |  |
| Website　URL |  |

**\*3DIC 2019 Web掲載用、ロゴをお送りください。（aiまたはeps形式及びJPEGの2種お送りください）**

Please attach the logo for 3DIC 2019 web and publication. ai/eps as well as jpeg format are highly recommended.

Other request if any:ご希望などがおありの場合はご記入ください。

|  |
| --- |
|  |

送付先：3DIC 2019事務局　株式会社セミコンダクタポータル

 〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-5　メソニック39MTビル4F

 Tel: 03-5733-4971 Fax: 03-57334973　　 Email: 3dic\_2019@semiconportal.com

お申込書受領後、事務局より請求書をお送り申し上げます。

Contact; 3DIC 2019 Secretariat c/o Semiconductor Portal, Inc.

 4F Mesonic 39MT bldg.., 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041

 Tel: +81-3-5733-4971 Email: 3dic\_2019@semiconportal.com